



**重庆市人民政府办公厅
关于印发《重庆市集成电路设计产业发展
行动计划（2023—2027年）》的通知**

渝府办发〔2023〕109号

各区县（自治县）人民政府，市政府各部门，有关单位：

《重庆市集成电路设计产业发展行动计划（2023—2027年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市人民政府办公厅

2023年12月29日

（此件公开发布）



重庆市集成电路设计产业发展行动计划

(2023—2027年)

为进一步提升我市集成电路产业设计能力，充分发挥设计环节的龙头带动作用，建设更具竞争力的集成电路产业集群，助力打造“33618”现代制造业集群体系，结合我市实际，制定本行动计划。

一、总体要求

(一) 发展思路及路径。

发挥我市集成电路特色工艺和整车整机产业优势，以提升市内集成电路协同水平、打造重庆区域 IDM（垂直整合制造）为重点，以集聚壮大市场主体为抓手，以加快引进培育设计人才为着力点，不断完善集成电路设计产业生态链，推动全市集成电路设计产业跨越式发展，打造以两江新区、西部科学城重庆高新区为主要载体的集成电路设计产业集群，为我市制造业高质量发展提供有力支撑。

——补齐产业链条短板，打造重庆区域 IDM。增强晶圆代

工能力，打造具有全国影响力的重庆区域 IDM，提升设计与制造、封测等环节协同发展、紧密衔接的水平，构建完善产业生态，有效吸引设计企业来渝集聚。

——发挥市场需求牵引作用，引育市场主体。围绕我市支柱产业中的重要应用场景，吸引一批高端集成电路设计龙头企业落地，培育壮大一批高成长性中小微集成电路设计企业。

——完善中试服务体系，做大做强优势特色领域。依托我市特色工艺技术优势和产业基础，聚焦模拟集成电路、功率半导体、化合物半导体、传感器等优势领域，构建特色工艺中试平台体系，加快集成电路设计企业的孵化培育。

（二）发展目标。

到 2027 年，全市集成电路设计产业营收突破 120 亿元；新增集成电路设计企业 100 家以上，其中营收超过 5 亿元的企业 1 家以上、营收超过 2 亿元的企业 4 家以上；培育一批“专精特新”“小巨人”“隐形冠军”企业；模拟芯片、硅光芯片、车规芯片、功率半导体、MEMS（微机电系统）传感器等设计水平全国领先；集成电路设计能力对支柱产业的支撑能力显著增强，建成具有重要全国影响力的集成电路设计产业集群。

二、重点任务



(一) 强化场景应用牵引。

1. 强化整机整车产业对本土芯片设计的吸纳能力。把握应用终端产品更新及供应链重构机遇，依托整机整车产业发展需求，吸引一批领先的集成电路设计企业在渝布局。推动集成电路设计企业与新能源汽车、智能终端、工业控制、轨道交通等整机整车应用企业联动发展，以整机整车产业升级推动芯片研发，以芯片研发支撑整机整车产业升级，推动产业链和创新链协同发展。鼓励整机整车应用企业采购我市集成电路设计产品。〔责任单位：市发展改革委、市经济信息委、市国资委、市科技局，有关区县（自治县，以下简称区县）政府〕

2. 推动应用场景落地。搭建供需对接平台，鼓励有条件的区县出台支持应用企业与设计企业、整体解决方案提供企业开展供需对接的政策，引导企业间提高合作频次、开发应用产品。开展设计项目和整体解决方案评选，做好宣传推介工作，推动我市集成电路设计企业新技术、新产品、新标准应用落地。（责任单位：市发展改革委、市科技局、市经济信息委，有关区县政府）

(二) 延伸产业链条。

3. 引进成熟工艺节点代工线。加强与集成电路制造企业合作，依托我市车用、工业、物联网、消费电子等应用领域通信和

控制处理芯片等需求，规划建设 28—55nm 成熟工艺制程的晶圆代工厂，大力争取晶圆代工龙头企业来渝布局。以晶圆代工龙头企业带动集成电路设计、制造、封测、材料、设备全面发展，形成集成电路产业优势集群。（责任单位：市发展改革委、市经济信息委、市招商投资局，有关区县市政府）

4. 加快推进关键材料战略备份。基于国家战略及我市集成电路制造产业需求，结合拟布局的成熟工艺制程晶圆代工生产线生产及中试体系研发需求，建立原材料统筹储存周转机制，加快打造集成电路生产用原材料战略备份基地，形成集成电路生产用原材料的保障能力。配套构建原材料应用验证平台，形成协同科技攻关能力，加快推进原材料国产化进程。（责任单位：市发展改革委、市经济信息委、市招商投资局，有关区县市政府）

（三）提升人才资源水平。

5. 加强人才培育。引导我市高校围绕集成电路设计产业发展需求，进一步优化学科专业设置。支持重庆大学、重庆邮电大学扩大微电子专业办学规模，建设集成电路科学与工程一级学科硕士及博士授权点，打造国家示范性微电子学院。大力推动产教融合、联合培养、定向补充，打通集成电路设计产业人才培养“最后一公里”。（责任单位：市教委、市人力社保局，有关区县政



府)

6. 加快人才引进。出台集成电路人才专项政策，加大集成电路设计人才引进力度，依托“渝跃行动”、新重庆引才计划等引才政策，加快从全球靶向引进高端领军人才、创新团队和管理团队。适当放宽人才认定标准，加大对中坚骨干力量、技术能手等多层次人才的支持力度。支持集成电路企业（科研机构）建设博士后科研工作站。（责任单位：市委组织部、市发展改革委、市经济信息委、市教委、市人力社保局，有关区县政府）

（四）强化技术创新及产业化建设。

7. 加大技术创新力度。深化征集、研究我市智能网联新能源汽车、人工智能、物联网、智慧医疗等数字化领域对集成电路设计技术的创新需求，加大专项攻关项目发布力度。鼓励集成电路应用龙头企业联合集成电路设计企业共同承担重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划。联合政产学研多方力量，推进构建专用芯片标准、验证、测试、认证体系。（责任单位：市科技局，有关区县政府）

8. 加快中试服务体系建设。针对功率半导体、硅基光电子、化合物半导体、MEMS等特色工艺方向，分类构建器件、芯片架构设计平台，工艺中试验证平台，封装测试平台和EDA（电



子设计自动化)工具、MPW(多项目晶圆加工)等配套服务平台。完善从研发、中试到量产的产业链条,推进中小微集成电路设计企业围绕中试平台聚集发展,有效降低企业运营成本,加速企业孵化进程。(责任单位:市科技局、市经济信息委,有关区县县政府)

(五)完善金融支持政策。

9. 强化产业基金牵引。充分运用重庆产业投资母基金发展集成电路产业,鼓励支持有条件的区县设立集成电路设计创业引导资金,推动集成电路设计产业生态培育和重大项目引进工作。积极探索产业基金投资新模式,促进产业与资本深度融合。(责任单位:市国资委、市金融监管局,有关区县县政府)

10. 创新投融资模式。鼓励各类金融机构加大对我市集成电路设计企业的信贷支持力度,支持金融机构推出满足集成电路设计企业融资需求的信贷创新产品。鼓励成立市场化投资基金,支持发展前景好的集成电路设计企业通过发行上市、并购重组、股权转让、债券发行、资产证券化等方式进行直接融资,促进资金加速向集成电路设计企业创新发展领域集聚。(责任单位:市金融监管局、重庆证监局、人行重庆市分行、国家金融监督管理总局重庆监管局,有关区县县政府)



三、保障措施

(一) 加强组织领导。

充分发挥重庆市高新技术产业工作专班(办公室设在市发展改革委)作用,统筹推进全市集成电路设计产业发展,督促推动相关项目落地建设,定期督导评估相关政策落实和任务完成情况。强化市、区县协调联动,有关区县要明确工作目标、工作任务、进度安排和保障措施,共同推动本行动计划各项任务落实。(责任单位:市发展改革委、市经济信息委、市科技局、市财政局、市国资委,有关区县)

(二) 加大政策支持力度。

1. 支持企业发展。对实际到位投资 2000 万元以上的集成电路设计类企业,按照其每款产品完成首次全掩膜工程流片费用 50%的比例给予资金支持(流片费用包括知识产权核授权费、掩膜版费、测试化验加工费),对单个企业年度支持总额最高 1000 万元。鼓励有条件的区县对拥有自主知识产权、年度营收首次有较大突破的集成电路设计企业给予一定奖励。(责任单位:市经济信息委,有关区县)

2. 支持平台建设。对已建成的市级集成电路公共服务平台,为集成电路设计企业提供 EDA 工具、仿真、知识产权库等公共



服务的，根据平台运行服务的情况，按照不超过企业运营费的10%给予奖励，对单个企业的奖励资金每年最高不超过400万元。支持有条件的区县建设用于重庆企业开展芯片研发支撑服务的集成电路产业公共服务平台，并根据项目总投资规模给予一定比例或者一定额度的补助。（责任单位：市经济信息委，有关区县政府）

（三）加强企业服务保障。

落实国务院关于新时期促进集成电路产业和软件高质量发展的相关政策，确保企业政策兑现实现“首接首问制”“一窗受理”。优化楼宇载体环境，按照“拎包入住”的标准打造楼宇空间，对新入驻的集成电路设计企业给予租金减免、购房装修、水电气讯等政策支持，并不断完善配套服务功能，打造优质创新创业生态。（责任单位：市经济信息委、重庆市税务局、市财政局，有关区县政府）